

Consesso scientifico sul packaging

Milano è stata scelta come sede del congresso internazionale Advances in the Packaging Industry in programma nel marzo 2025.

1 agosto 2024 08:43

Promosso da Giflex in collaborazione con alcuni atenei italiani, il congresso scientifico internazionale Advances in the Packaging Industry (API) si terrà a Milano il 27 e 28 marzo 2025 presso la Fondazione Cariplo.



La quinta edizione del convegno, intitolato “Sustainability: Products and Processes”, affronterà temi di stretta attualità tecnica e scientifica per il mondo dell'imballaggio flessibile, quali ecodesign e LCA per l'economia circolare, riciclo chimico, materiali biodegradabili e smart per il packaging, processi sostenibili per la laminazione, la stampa e il converting, innovazioni tecnologiche per rivestimenti e trattamento delle superfici. Si parlerà anche delle più recenti normative, di rischi e sicurezza dei processi produttivi, di materiali e tecnologie per la conservazione del cibo e della valorizzazione dei materiali post consumo, oltre che delle nuove prospettive che si sono aperte per i materiali a base cellulosica.

Il programma, in fase di definizione, prevede due sessioni principali incentrate su Prodotti e Processi. Presiedono il Comitato scientifico: Domenico Acierno di CRdC, Loredana Incarnato dell'Università di Salerno e Alberto Palaveri, presidente di Giflex.

Le precedenti edizioni si sono tenute a Napoli nel 2015, a Milano nel 2017 e nel 2022, oltre all'incontro virtuale del 2021.

Per informazioni: [Congresso API 2025](#)

© Polimerica - Riproduzione riservata